

小型 D 級スピーカアンプシリーズ

ALC 内蔵

モノラル D 級スピーカアンプ

BD5469GUL

概要

BD5469GUL は、携帯電話、携帯型電子機器などのモバイル・オーディオ製品用の ALC 機能を内蔵したモノラル D 級スピーカアンプです。スピーカ出力の LC フィルタが不要で、外付け部品 3 個でモノラルスピーカアンプを構成することができます。ALC は Automatic Level Control の略で、過大入力時に出力波形の歪み(クリップ)を低減するレベルまで自動調整する機能です。クリップノイズ低減による高音質、過大出力防止によるスピーカ保護にメリットのある機能です。出力レベルのリミット解除動作までの時間をリリースタイム(もしくはリカバリタイム)と呼びます。本 IC は、音楽再生に適したリリースタイム(262ms/1dB Typ)を採用しています。D 級動作により効率が高く低消費電力のため、バッテリー駆動のアプリケーションに最適です。シャットダウン時の消費電流が 0.01 μ A(Typ)と低く、シャットダウンから動作時への起動が早く、ポップ音が少ないので、シャットダウン、アクティブを繰り返す用途にも適しています。

特長

- デジタル ALC 機能内蔵
- 外付け部品 : 3 点
- 超小型パッケージ : 9pin
WL-CSP(1.7×1.7×0.55mmMax)
- ピンコンパチブル仕様
BD5460/61GUL(ALC 機能なし, ゲイン固定品)
BD5465/66/67/68GUL(ALC 機能あり, ゲイン固定品)
- 最大ゲイン : 13dB(Typ)
[ALC 動作時, +13~-2dB@1dB Step]
- ALC リリース(リカバリ)タイム : 262ms/1dB(Typ)
- リミット出力電力
: 0.88W (Typ)[$V_{DD}=4.2V$, $R_L=8\Omega$, $THD+N \leq 1\%$]
: 0.9W(Typ)[$V_{DD}=3.7V$, $R_L=6\Omega$, $THD+N \leq 1\%$]
: 0.64W (Typ)[$V_{DD}=3.6V$, $R_L=8\Omega$, $THD+N \leq 1\%$]
- オーディオアナログ入力(差動/シングル入力両対応)
- 出力フィルタレス
- ポップノイズ低減回路
- シャットダウン機能(ミュート兼用)
[低シャットダウン電流=0.01 μ A (Typ)]
- 保護回路内蔵 :
出力ショート, サーマルシャットダウン, 減電保護

用途

- 携帯電話、ポータブルオーディオ機器、PND、DSC、ノート PC など

重要特性

- 電源電圧範囲 : 2.5V ~ 5.5V
- 全高調波歪+ノイズ : 0.2%(0.3W, $R_L=8\Omega$, Typ)
- スイッチング周波数 : 250kHz(Typ)
- シャットダウン電流 : 0.01 μ A (Typ)
- 動作温度範囲 : -40°C ~ +85°C

パッケージ

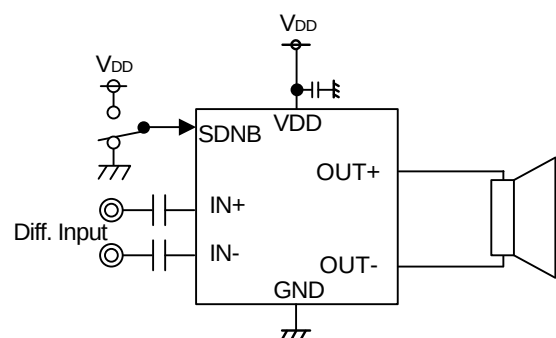
VCSP50L1

W(Typ) x D(Typ) x H(Max)

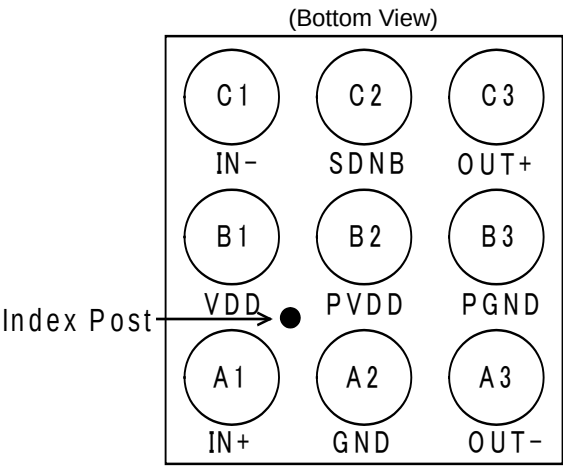
1.70mm x 1.70mm x 0.55mm



基本アプリケーション回路



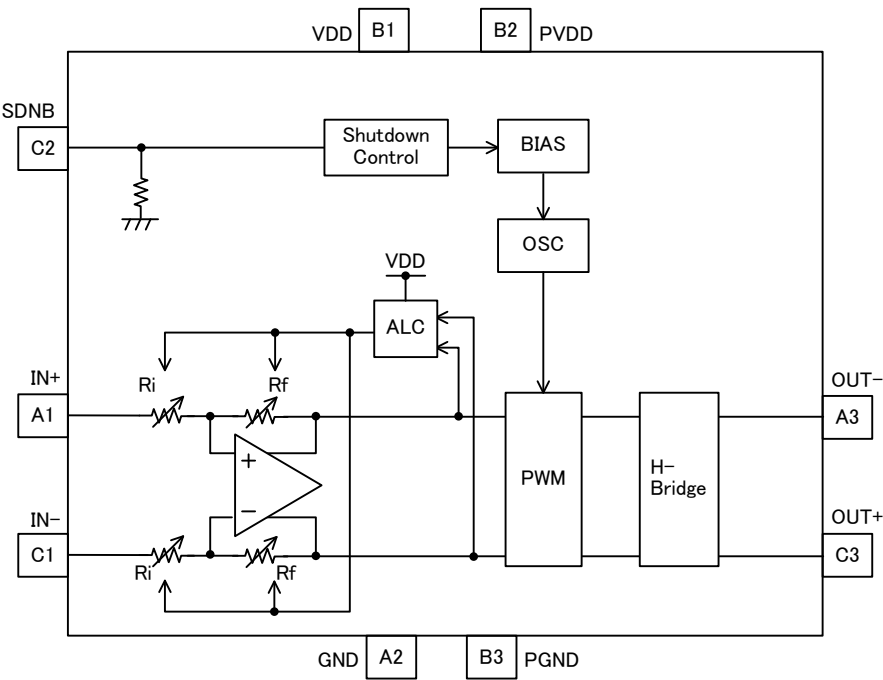
端子配置図



端子説明

端子番号	記 号	機 能
A1	IN+	オーディオ差動入力+端子
A2	GND	GND 端子(シグナル)
A3	OUT-	D 級 BTL 出力-端子
B1	VDD	VDD 端子 (シグナル)
B2	PVDD	VDD 端子(パワー)
B3	PGND	GND 端子(パワー)
C1	IN-	オーディオ差動入力-端子
C2	SDNB	シャットダウン制御端子
C3	OUT+	D 級 BTL 出力+端子

ブロック図



絶対最大定格(Ta = 25°C)

項 目	記号	定 格	単位
電源電圧 (VDD、PVDD)	VDD PVDD	-0.3 ~ +7.0	V
許容損失	Pd	0.69 ^(Note 1)	W
動作温度範囲	Topr	-40 ~ +85	°C
保存温度範囲	Tstg	-55 ~+150	°C
ジャンクション温度	Tjmax	150	°C
SDNB、IN+、IN-電圧	VIN	-0.3 ~ +7	V
OUT 電圧	VOU	-0.3 ~ +7	V

(Note 1) Ta=25°C 以上は、5.52mW/°C で軽減。70mm x 70mm x 1.6mm 1 層ガラエポ基板実装時。

注意：印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。
また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。
絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、
ヒューズなど物理的な安全対策を施して頂けるようご検討をお願いします。

推奨動作条件(Ta= -40°C to +85°C)

項 目	記号	最小	標準	最大	単位
電源電圧	VDD PVDD	2.5	3.6	5.5	V
同相入力電圧範囲	VIN	+0.5	-	VDD-0.8	V
負荷抵抗	RL	3.6	-	-	Ω

電氣的特性(特に指定のない限り $V_{DD}=3.6V$ $T_a=25^{\circ}C$)

項 目	記号	最小	標準	最大	単位	条 件
デバイス全体						
無信号時回路電流	I_{CC}	-	3	6	mA	IC アクティブ, 無負荷 $V_{SDNB}=V_{DD}$
シャットダウン時回路電流	I_{SDN}	-	0.01	2	μA	IC シャットダウン $V_{SDNB}=GND$
オーディオ特性						
リミット出力電力	P_O	$0.044 \times V_{DD}^2$	$0.050 \times V_{DD}^2$	$0.055 \times V_{DD}^2$	W	BTL, $f=1kHz$, $R_L=8\Omega$ $THD+N \leq 1\%$, (Note 2)
全高調波歪率	T_{HD+N}	-	0.2	1	%	BTL, $f_{IN}=1kHz$, $R_L=8\Omega$ $P_O=0.3W$, (Note 2)
最大ゲイン	G_{MAX}	12	13	14	dB	BTL, (Note 2)
ALC リミットレベル	V_{LIM}	$1.68 \times V_{DD}$	$1.78 \times V_{DD}$	$1.89 \times V_{DD}$	V_{P-P}	BTL, (Note 2)
ALC リリースレベル	V_{REL}	$1.34 \times V_{DD}$	$1.41 \times V_{DD}$	$1.5 \times V_{DD}$	V_{P-P}	BTL, (Note 2)
スイッチング周波数	f_{OSC}	150	250	350	kHz	
起動時間	T_{ON}	0.73	1.02	1.71	msec	
オーディオ入力抵抗	R_i	47	72	97	k Ω	Gain=13dB
<制御端子>						
SDNB 端子 H レベル	V_{SDNBH}	1.4	-	V_{DD}	V	IC アクティブ
SDNB 端子 L レベル	V_{SDNBL}	0	-	0.4	V	IC シャットダウン
SDNB 端子流入電流	I_{SDBNH}	24	48	72	μA	$V_{SDNB}=3.6V$ (流入)
SDNB 端子流出電流	I_{SDNBL}	0	-	± 5	μA	$V_{SDNB}=0V$ (流出)

(Note 2) 測定用フィルタ帯域幅 : 400Hz~30kHz, AC 測定用 LC フィルタ : $L=22\mu H$ / $C=1\mu F$, BTL : A3,C3 ピン間電圧

特性データ(参考データ)

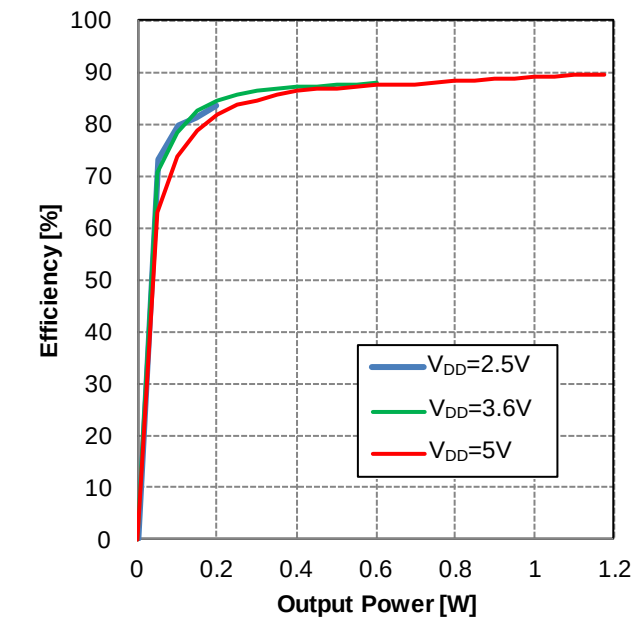


Figure 1. Efficiency vs Output Power
(f=1kHz, $R_L=8\Omega+33\mu\text{H}$)

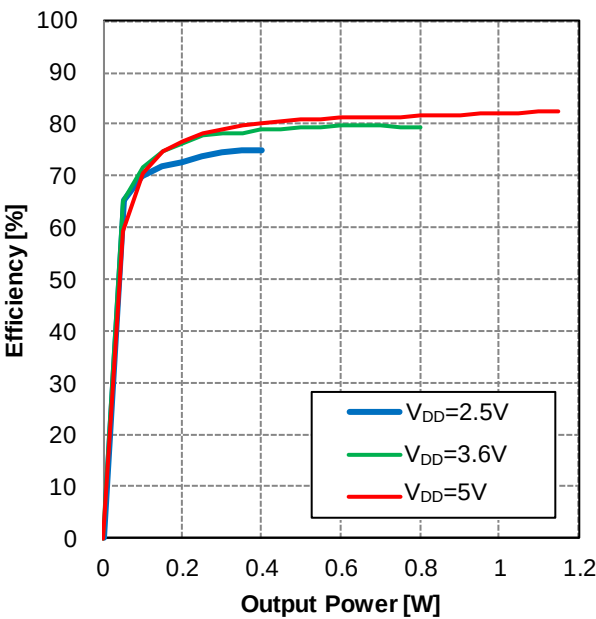


Figure 2. Efficiency vs Output Power
(f=1kHz, $R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$)

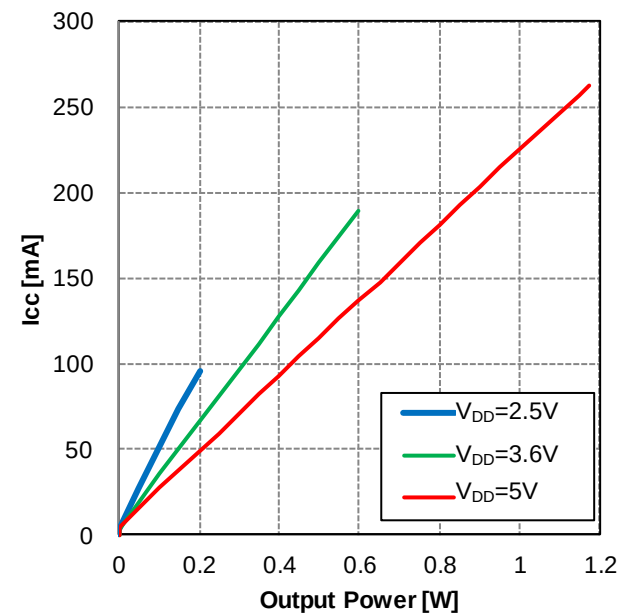


Figure 3. Supply Current vs Output Power
(f=1kHz, $R_L=8\Omega+33\mu\text{H}$)

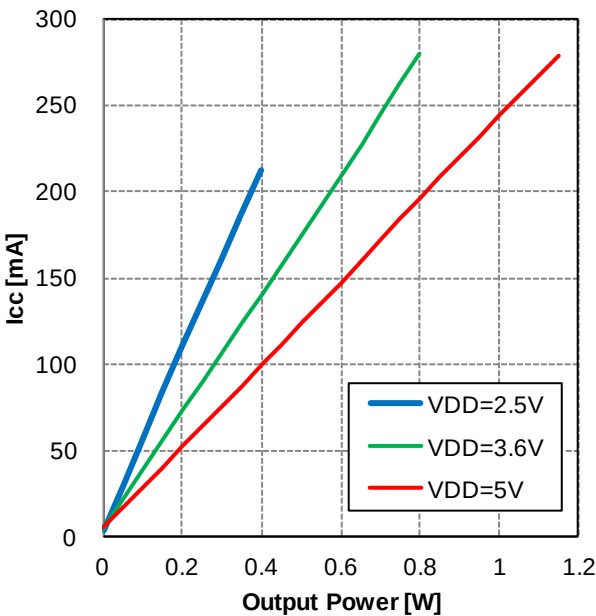


Figure 4. Supply Current vs Output Power
(f=1kHz, $R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$)

特性データ(参考データ) ー 続き

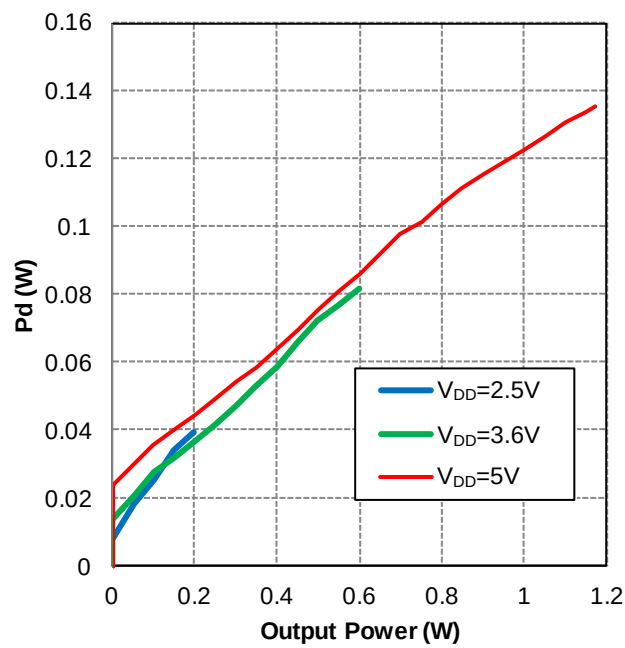


Figure 5. Power Dissipation vs Output Power (f=1kHz, $R_L=8\Omega+33\mu\text{H}$)

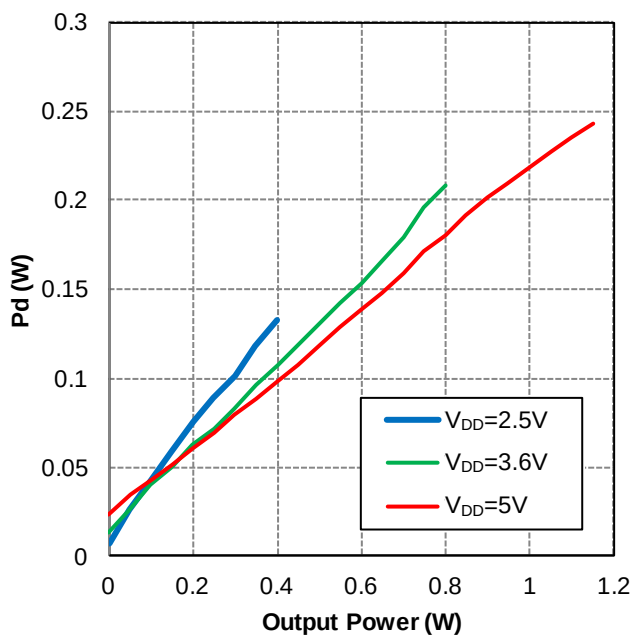


Figure 6. Power Dissipation vs Output Power (f=1kHz, $R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$)

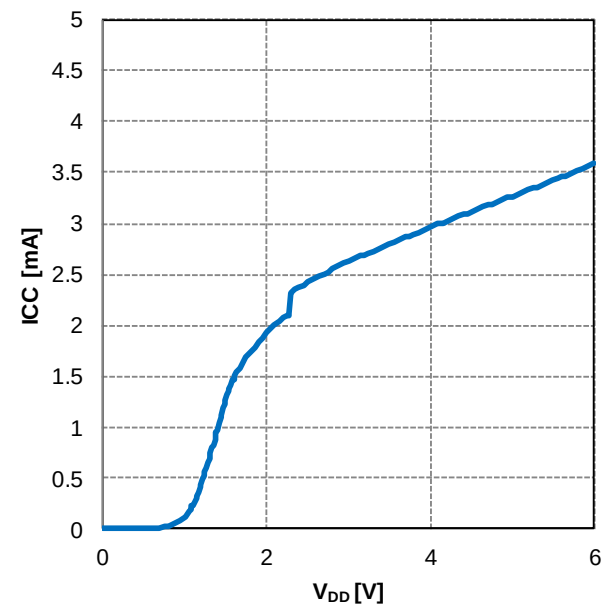


Figure 7. Supply Current vs Power Supply (No Load, No Signal)

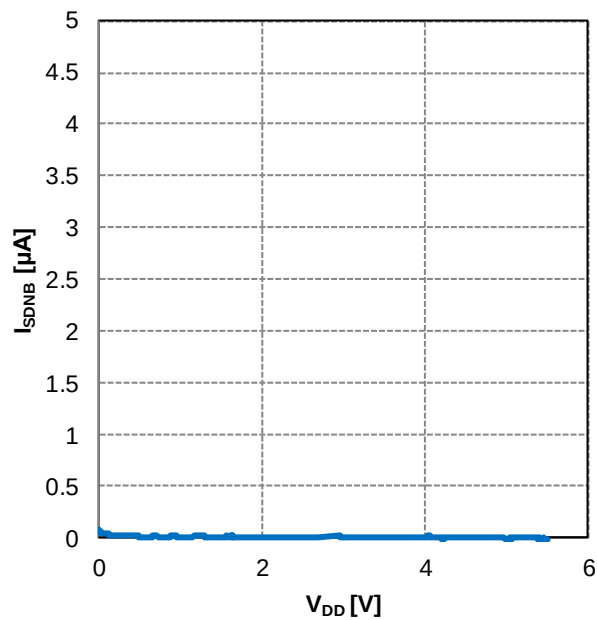


Figure 8. Shutdown Current vs Power Supply (No Load, No Signal)

特性データ(参考データ) ー 続き

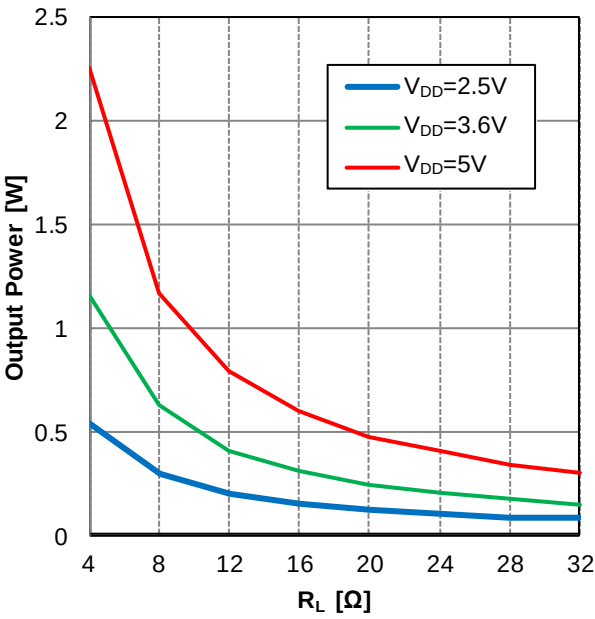


Figure 9. Output Power vs Load Resistance
(f=1kHz)

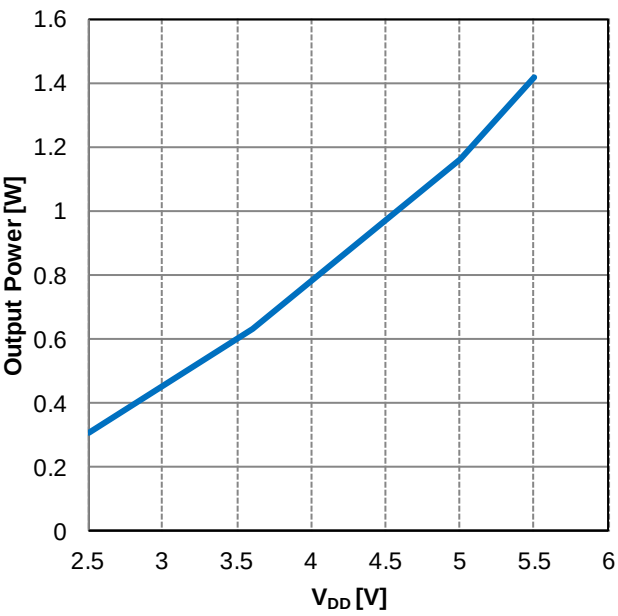


Figure 10. Output Power vs Power Supply
(f=1kHz, $R_L=8\Omega$)

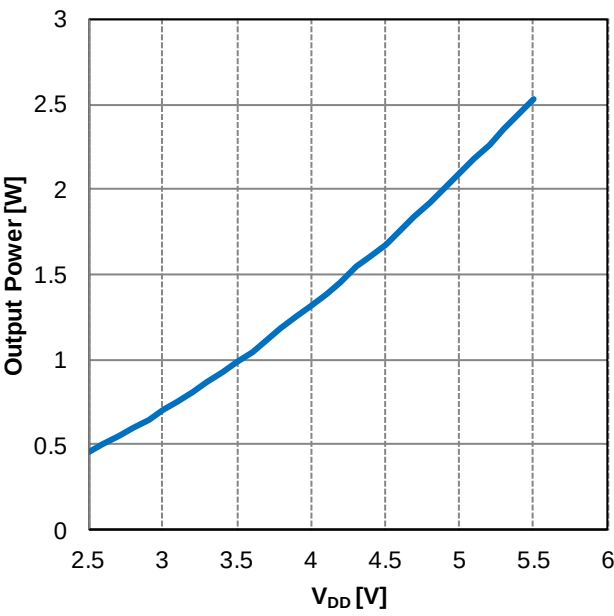


Figure 11. Output Power vs Power Supply
(f=1kHz, $R_L=4\Omega$)

特性データ(参考データ) ー 続き

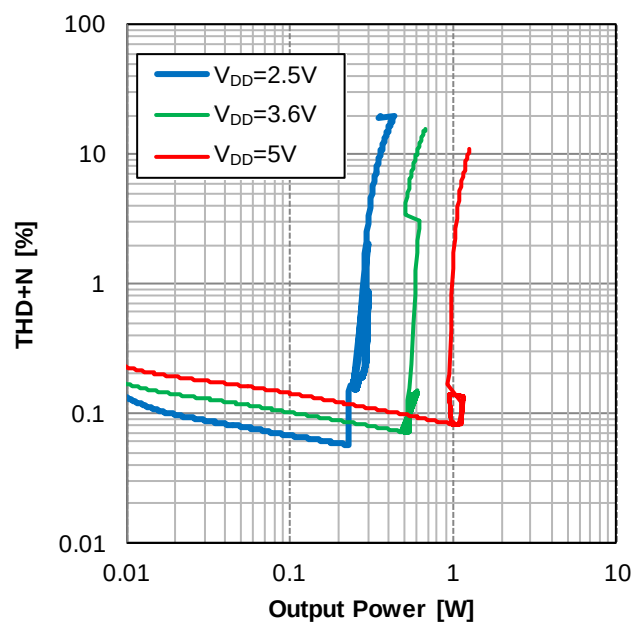


Figure 12. THD+N vs Output Power
($f=1kHz$, $R_L=8\Omega$, 400Hz-30kHz BPF)

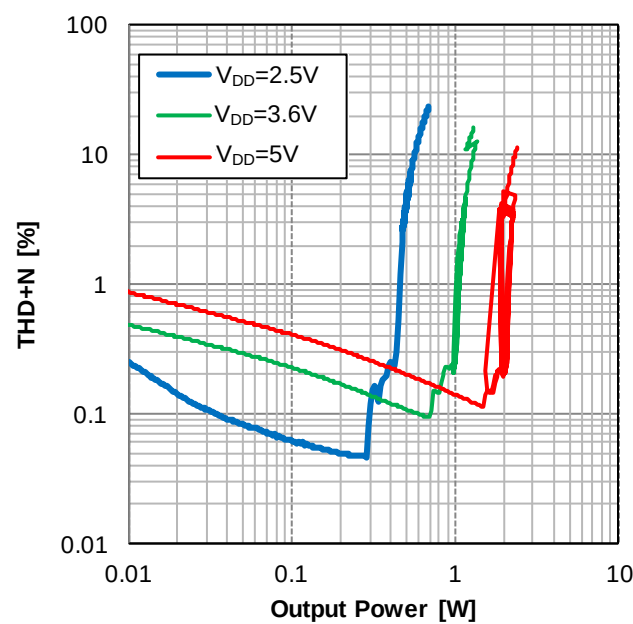


Figure 13. THD+N vs Output Power
($f=1kHz$, $R_L=4\Omega$, 400Hz-30kHz BPF)

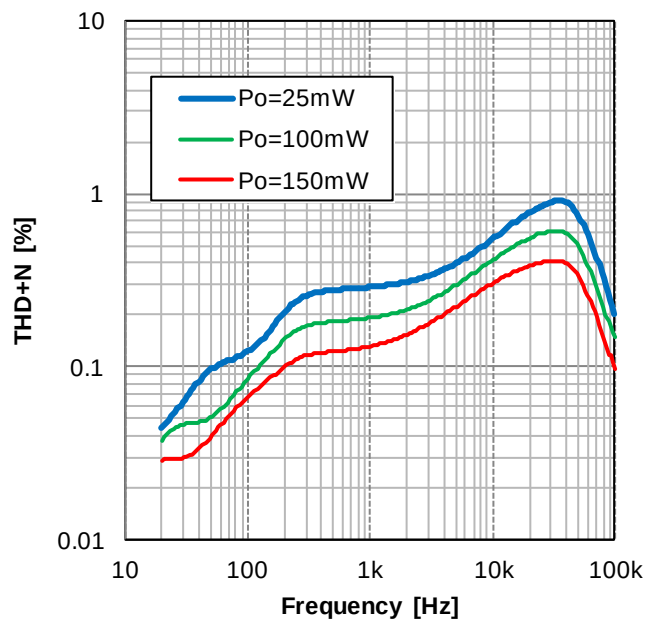


Figure 13. THD+N vs Frequency
($V_{DD}=5.0V$, $f=1kHz$, $R_L=8\Omega$, 400Hz-30kHz BPF)

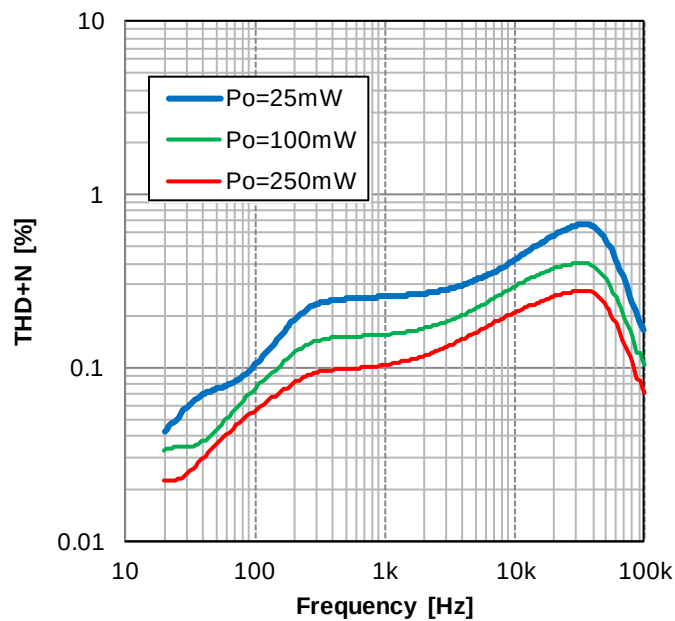


Figure 14. THD+N vs Frequency
($V_{DD}=3.6V$, $f=1kHz$, $R_L=8\Omega$, 400Hz-30kHz BPF)

特性データ(参考データ) ー 続き

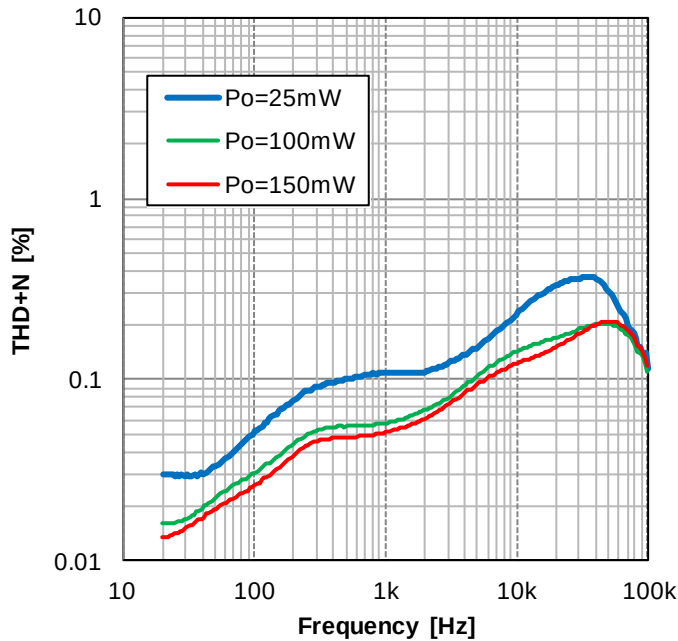


Figure 15. THD+N vs Frequency
($V_{DD}=2.5V$, $f=1kHz$, $R_L=8\Omega$, 400Hz-30kHz BPF)

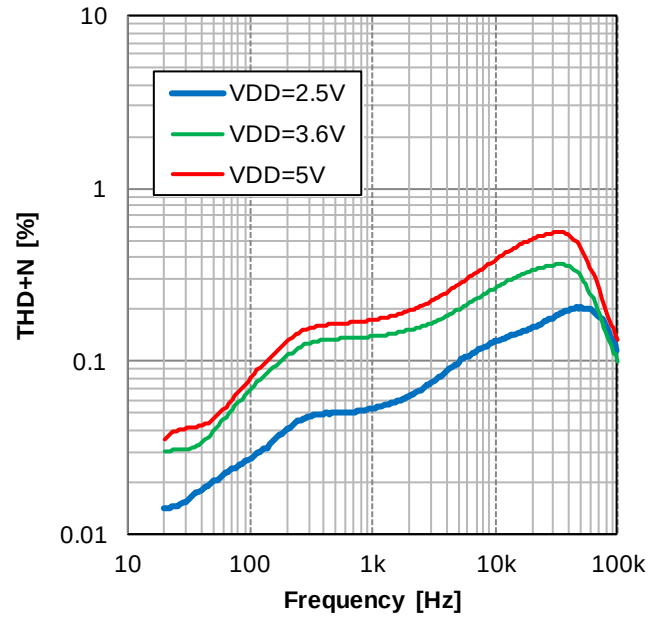


Figure 16. THD+N vs Frequency
($f=1kHz$, $R_L=8\Omega$, $P_o=125mW$, 400Hz-30kHz BPF)

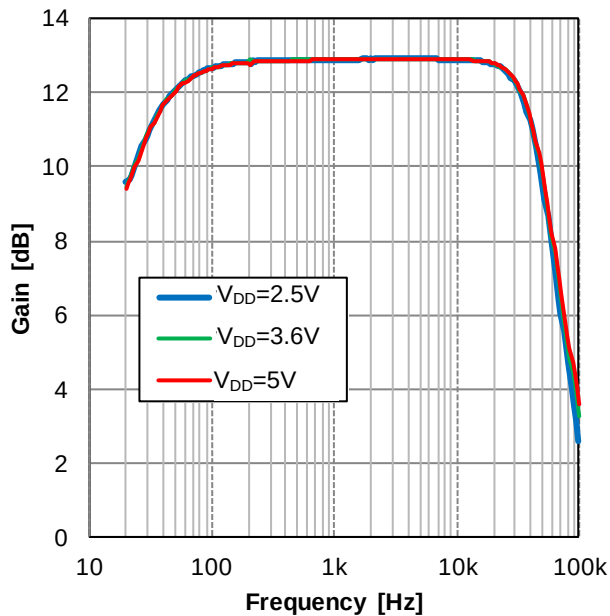


Figure 17. Gain vs Frequency
($V_{in}=0.5V_{P-P}$, $R_L=8\Omega$, 400Hz-30kHz BPF)

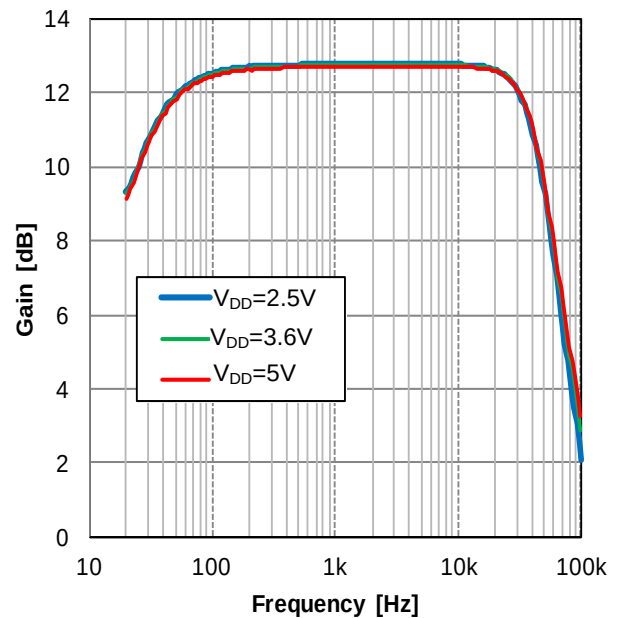
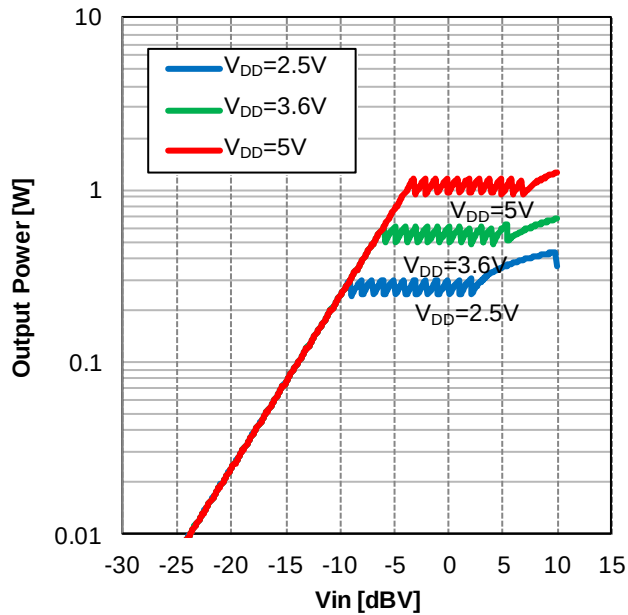
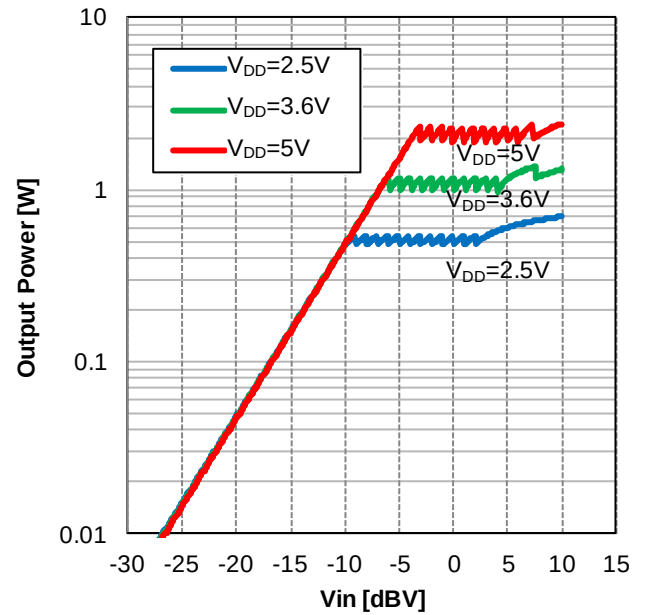
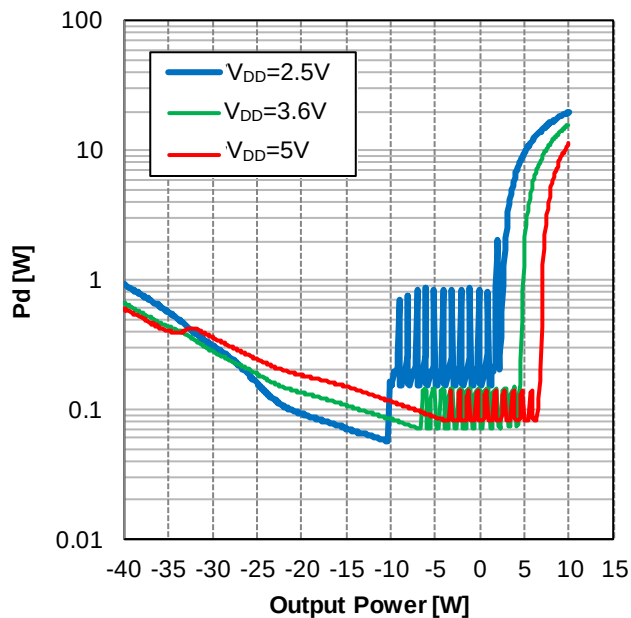
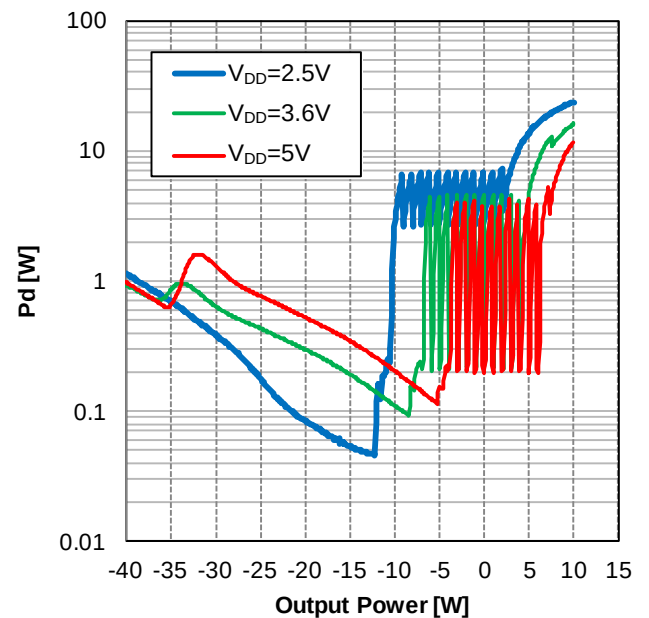


Figure 18. Gain vs Frequency
($V_{in}=0.5V_{P-P}$, $R_L=4\Omega$, 400Hz-30kHz BPF)

特性データ(参考データ) ー 続き

Figure 19. Output Power vs Input Level
(f=1kHz, $R_L=8\Omega$)Figure 20. Output Power vs Input Level
(f=1kHz, $R_L=4\Omega$)Figure 21. THD+N vs Output Power
(f=1kHz, $R_L=8\Omega$, 400Hz-30kHz BPF)Figure 22. THD+N vs Output Power
(f=1kHz, $R_L=4\Omega$, 400Hz-30kHz BPF)

特性データ(参考データ) ー 続き

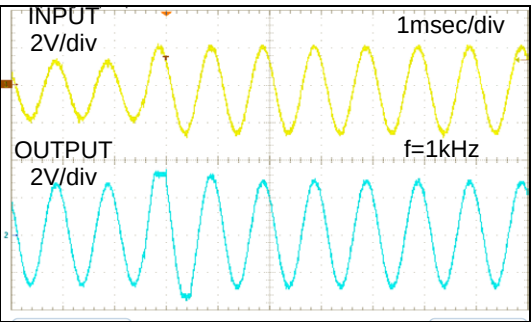


Figure 23. ALC Limit waveform
($V_{DD}=3.6V$, $R_L=8\Omega$)

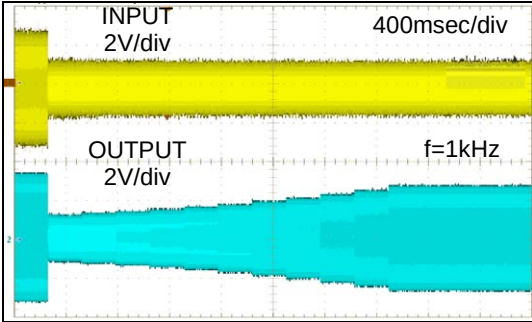


Figure 24. ALC Release waveform
($V_{DD}=3.6V$, $R_L=8\Omega$)

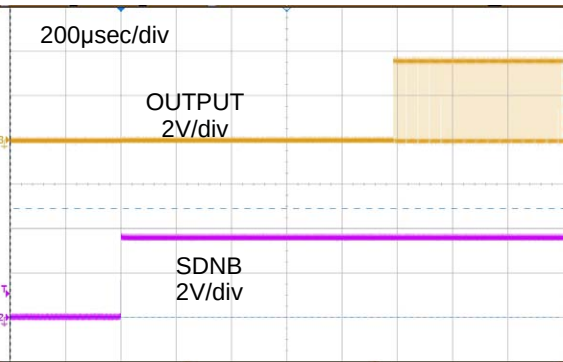


Figure 25. Start waveform
($V_{DD}=3.6V$, $R_L=8\Omega$)

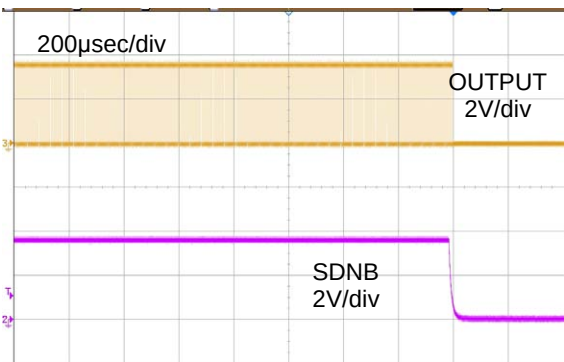


Figure 26. Shutdown waveform
($V_{DD}=3.6V$, $R_L=8\Omega$)

Application Information

1. シャットダウン制御

制御端子	状態
SDNB	
H	IC 動作(アクティブ)
L	IC 停止(シャットダウン)

2. ALC パラメータ

ALC パラメータ		
アタックタイム(Typ)	リリースタイム(Typ)	ゲイン切替ステップ(Typ)
$\sim 1\text{ms}/1\text{dB}@f_{\text{IN}}=100\text{Hz}$ $\sim 0.5\text{ms}/1\text{dB}@f_{\text{IN}}=1\text{kHz}$ $\sim 0.05\text{ms}/1\text{dB}@f_{\text{IN}}=10\text{kHz}$	$262\text{ms}/1\text{dB}$ $@ f_{\text{IN}}=100\text{Hz}\sim 10\text{kHz}$	$\pm 1\text{dB}$

ALC 動作時のゲイン切替タイミングは、Audio 出力電圧のゼロクロス点で行います。
 そのため、アタックタイム、リリースタイムは入力周波数 f_{IN} で変化します。
 ALC パラメータは固定です。インパルス性のノイズには対応しておりません。

3. 保護機能について

保護機能	検出・解除条件		スピーカ PWM
			出力端子
出力ショート保護	検出条件 :	検出電流 = 2.5A (Typ)	High Z (ラッチ)
高温保護	検出条件 :	チップ温度が 180°C (Typ)以上	High Z
	解除条件 :	チップ温度が 110°C (Typ)以下	通常動作
減電圧保護	検出条件 :	電源電圧が 2.2V (Typ)以下	1kΩ pulldown
	解除条件 :	電源電圧が 2.3V (Typ)以上	通常動作

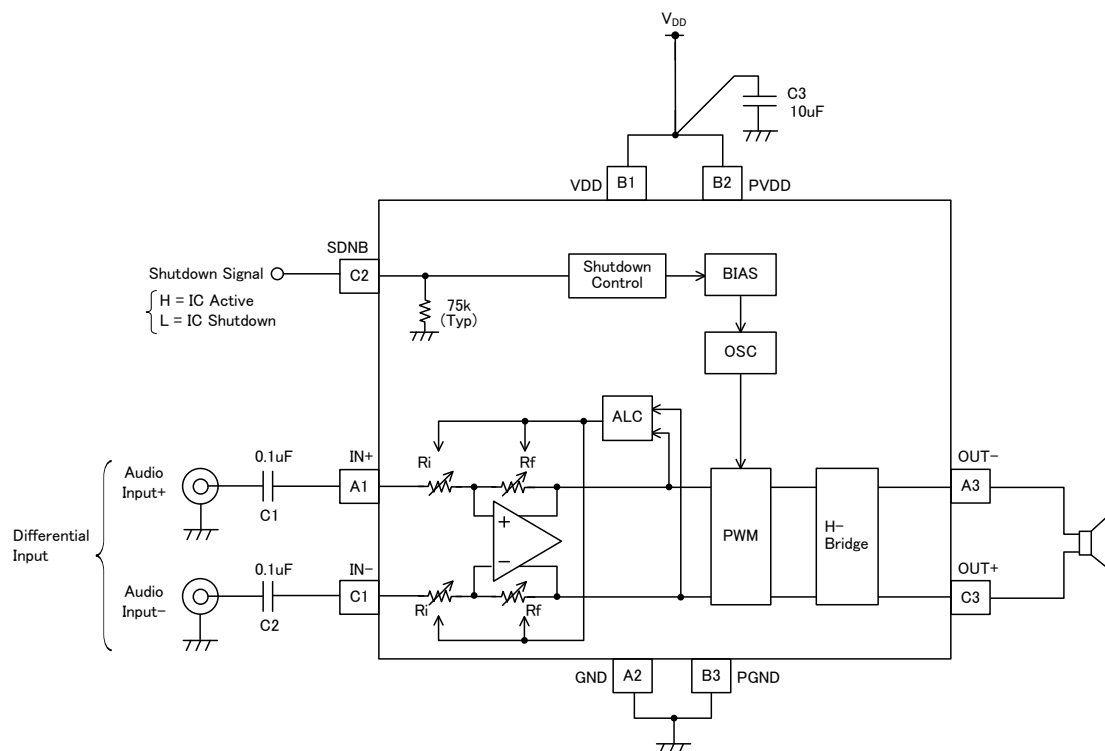
※ ラッチ状態になると、異常状態が解除されても自動復帰しません。次の①または②の方法で解除できます。

1 SDNB 端子を一旦 Low(Low に保持する時間=10msec(Min.))にした後、再度 High に戻す。

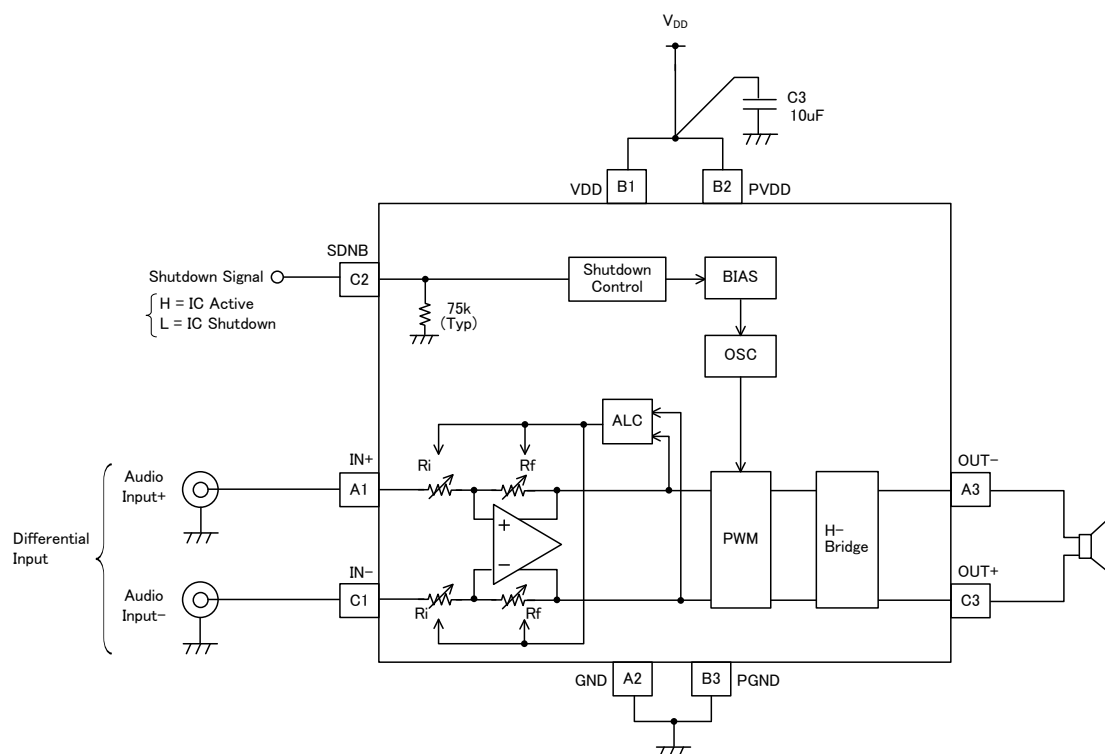
2 内部パワーオンリセット回路が動作する電源電圧 $V_{\text{DD}} < 1\text{V}$ (10msec(Min)保持)に落としてから、電源を再投入してください。

応用回路例

応用回路図例 1: 差動入力、入力カップリングコンデンサ有り

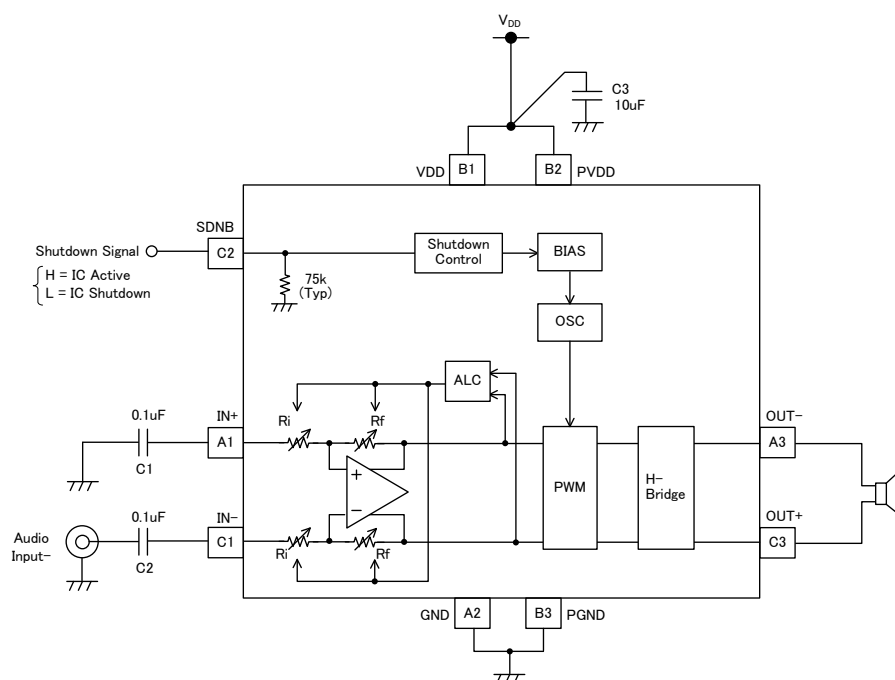


応用回路図例 2: 差動入力、入力カップリングコンデンサ無し



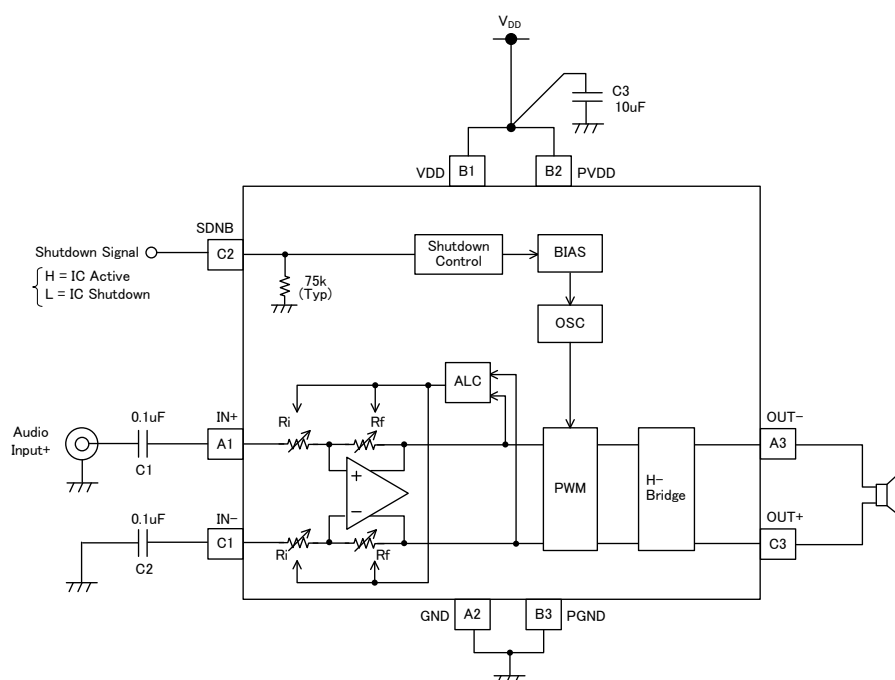
0.5V~ V_{DD} -0.8V の範囲でバイアスされた差動信号を使用する場合、入力カップリングコンデンサは必要ありません。

応用回路図例 3: シングルエンド入力(IN-)



出力(OUT+ - OUT-)は、IN-入力に対し逆位相となります。

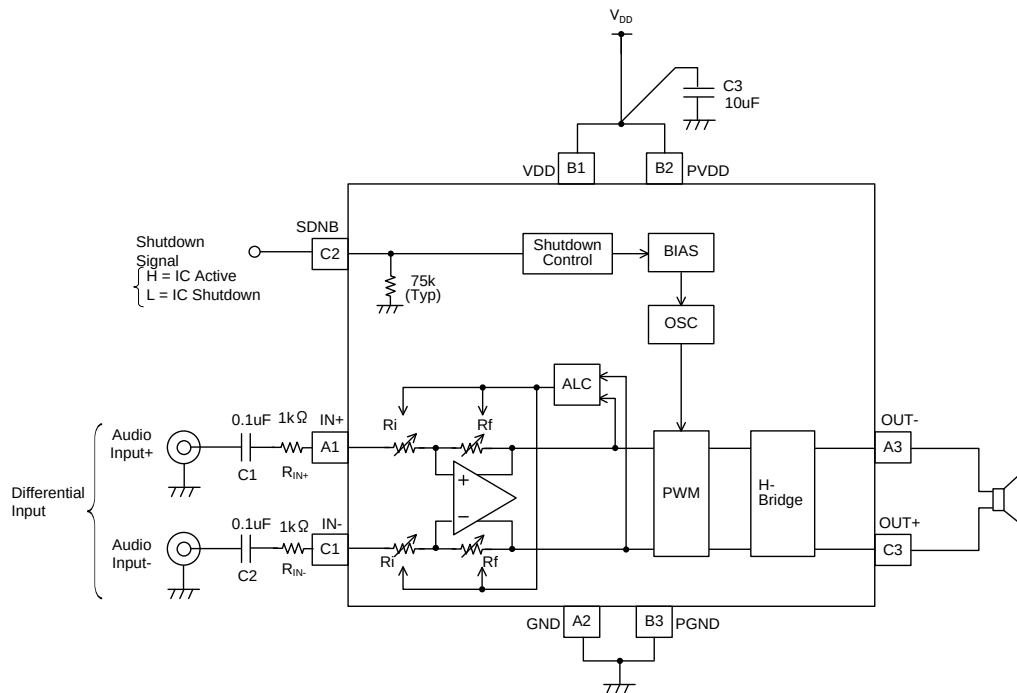
応用回路図例 4: シングルエンド入力(IN+)



出力(OUT+ - OUT-)は、IN+入力に対し同位相となります。

シングルエンド入力時には、Audio 無入力端子は OPEN ではなく入力カップリングコンデンサを介して上記の例のように GND へ接続してください。また、Audio 入力端子は、信号入力しない場合は出力ノイズを防ぐため、前段 Audio 出力が High-Z にならないようにしてください。

応用回路図例 5: 差動入力、入力カップリングコンデンサ有り SDNB=L 時入力プルダウン抵抗 1kΩ がドライブできない場合。



SDNB=L 時、入力端子は 1kΩ でプルダウンされます(入出力等価回路図参照)。このため、オーディオ入力するにはドライブ能力にご注意下さい。入力ラインのドライブ能力が不足している場合には、上図のように 1kΩ を端子に挿入してください。1kΩ を挿入した場合でも、出力の ALC レベルに影響はありません。

アプリケーション部品選定方法

① 入力カップリングコンデンサ(C1,C2)

入力カップリングコンデンサは、0.1μF としています。

入力インピーダンスは最大ゲイン 13dB 時、72kΩ(Typ)です。入力カップリングコンデンサと入力インピーダンスにより、ハイパスフィルタが構成されます。

カットオフ周波数 f_c は、入力カップリングコンデンサ C ($C=C1=C2$) と入力インピーダンス R_i により、以下の式で設定します。

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times R_i \times C} \quad [\text{Hz}]$$

$R_i=72\text{k}\Omega$, $C(=C1=C2)=0.1\mu\text{F}$ の場合、カットオフ周波数 f_c =約 22Hz になります。

② 電源デカップリングコンデンサ(C3)

電源デカップリングコンデンサは、10μF としています。電源デカップリングコンデンサの容量値を小さくした場合、THD+N の悪化、ALC リミットレベルの低下、ALC リリースレベルの低下が生じます。小さくする場合には、実機においてオーディオ特性の確認をお願いいたします。ESR(等価直列抵抗)が充分低いコンデンサをご使用ください。

熱損失について

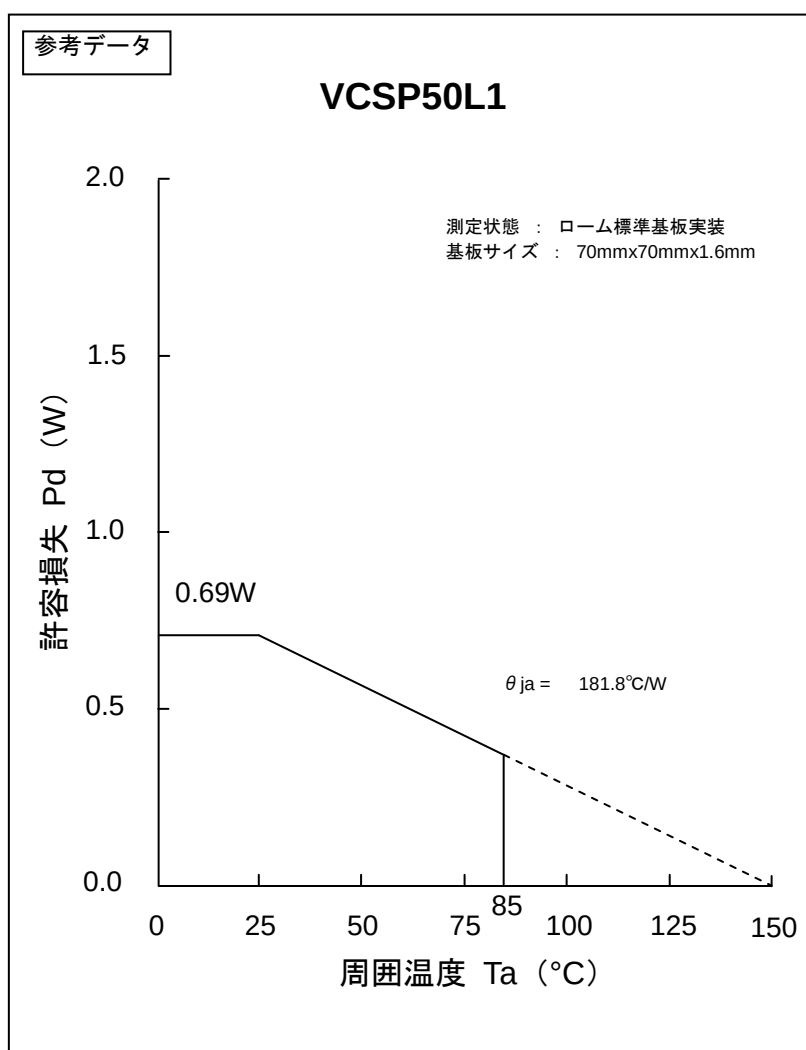
IC の特性は、使用される温度に大きく関係し、最大許容接合部温度を超えると、素子が劣化したり破壊したりすることがあります。瞬時破壊および長時間動作の信頼性といった 2 つの立場から、IC の熱に対する配慮は十分に行う必要があります。次のような点に注意してください。

IC の絶対最大定格は、最大接合部温度(T_{JMAX})または動作温度範囲(T_{opr})を示していますので、この値を参考に Pd-Ta 特性(熱軽減率曲線)を利用して求めてください。

放熱が不十分な状態で入力信号を過大にすると、TSD (サーマルシャットダウン) が作動することがあります。

TSD は、チップ温度が約 180°C で動作し、約 110°C 以下になると解除されるようになっています。TSD はあくまでチップの破壊を防ぐ目的で動作しますので、TSD が動作する付近での長時間の使用は IC の信頼性を低下させますのでご注意ください。

熱軽減率曲線



注)この値は実測値であり保証値ではありません。

許容損失の値は実装する基板によって変化します。

放熱設計された多層基板実装時に本 IC の許容損失は、上記のグラフの値より大きくなります。

入出力等価回路図

端子番号	端子名称	端子電圧(TYP)	端子説明	内部等価回路
C2	SDNB	0V	シャットダウン端子 H: ACTIVE L: Shutdown	
A1	IN+	0V	Audio 差動入力端子+ PDNB=L 時 1kΩ プルダウン	
C1	IN-	0V	Audio 差動入力端子- PDNB=L 時 1kΩ プルダウン	
A3	OUT-	0V	D 級 BTL 出力-端子	
C3	OUT+		D 級 BTL 出力+端子	
B1	VDD	-	VDD 端子(シグナル)	-
B2	PVDD	-	VDD 端子(パワー)	-
A2	GND	-	GND 端子(シグナル)	-
B3	PGND	-	GND 端子(パワー)	-

使用上の注意

1. 電源の逆接続について

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れる等の対策を施してください。

2. 電源ラインについて

基板パターンの設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。その際、デジタル系電源とアナログ系電源は、それらが同電位であっても、デジタル系電源パターンとアナログ系電源パターンは分離し、配線パターンの共通インピーダンスによるアナログ電源へのデジタル・ノイズの回り込みを抑止してください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。

また、LSI のすべての電源端子について電源ーグラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量ぬげが起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

3. グラウンド電位について

グラウンド端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。

4. グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

5. 熱設計について

万一、許容損失を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。本仕様書の絶対最大定格に記載しています許容損失は、70mm x 70mm x 1.6mm ガラスエポキシ基板実装時、放熱板なし時の値であり、これを超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用する等の対策をして、許容損失を超えないようにしてください。

6. 推奨動作条件について

この範囲であればほぼ期待通りの特性を得ることが出来る範囲です。電気特性については各項目の条件下において保証されるものです。推奨動作範囲内であっても電圧、温度特性を示します。

7. ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

8. 強電磁界中の動作について

強電磁界中でのご使用では、まれに誤動作する可能性がありますのでご注意ください。

9. セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

10. 端子間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けした場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源およびグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

使用上の注意 — 続き

11. 未使用の入力端子の処理について

CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また 論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれていない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

12. 各入力端子について

本 IC はモノリシック IC であり、各素子間に素子分離のための P+アイソレーションと、P 基板を有しています。

この P 層と各素子の N 層とで P-N 接合が形成され、各種の寄生素子が構成されます。

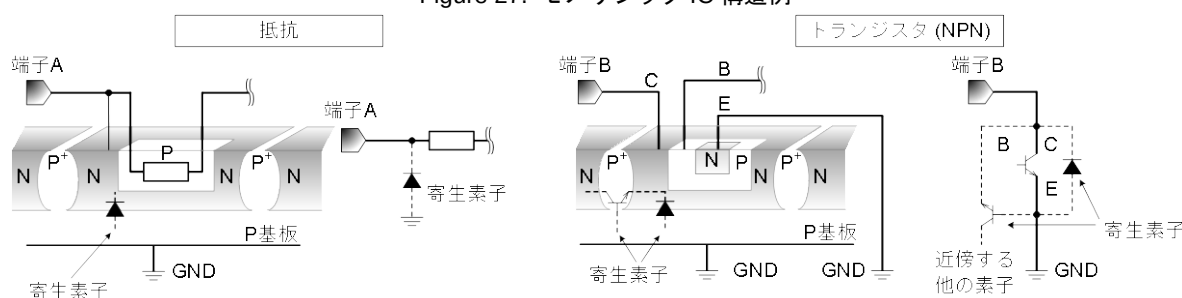
例えば、下図のように、抵抗とトランジスタが端子と接続されている場合、

○抵抗では、GND > (端子 A) の時、トランジスタ (NPN) では GND > (端子 B) の時、P-N 接合が寄生ダイオードとして動作します。

○また、トランジスタ (NPN) では、GND > (端子 B) の時、前述の寄生ダイオードと近接する他の素子の N 層によって寄生の NPN トランジスタが動作します。

IC の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的にできます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因ともなり得ます。したがって、入出力端子に GND (P 基板) より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分に注意してください。アプリケーションにおいて電源端子と各端子電圧が逆になった場合、内部回路または素子を損傷する可能性があります。例えば、外付けコンデンサに電荷がチャージされた状態で、電源端子が GND にショートされた場合などです。また、電源端子直列に逆流防止のダイオードもしくは各端子と電源端子間にバイパスのダイオードを挿入することを推奨します。

Figure 27. モノリシック IC 構造例



13. セラミック・コンデンサの特性変動について

外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮の上定数を決定してください。

14. 安全動作領域について

本製品を使用する際には、出力トランジスタが絶対最大定格及び ASO を越えないよう設定してください。

15. 温度保護回路について

IC を熱破壊から防ぐための温度保護回路を内蔵しております。許容損失範囲内でご使用いただきますが、万が一許容損失を超えた状態が継続すると、チップ温度 T_j が上昇し温度保護回路が動作し出力パワー素子が OFF します。その後チップ温度 T_j が低下すると回路は自動で復帰します。なお、温度保護回路は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、温度保護回路を使用したセット設計等は、絶対に避けてください。

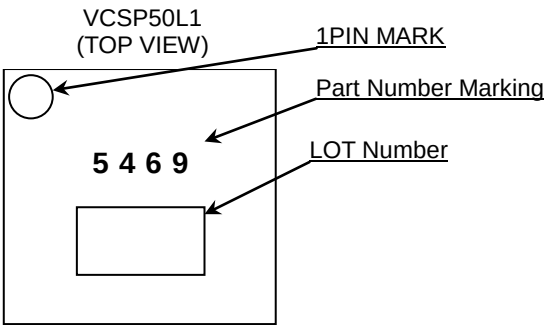
16. 過電流保護回路について

出力には電流能力に応じた過電流保護回路が内部に内蔵されているため、負荷ショート時には IC 破壊を防止しますが、この保護回路は突発的な事故による破壊防止に有効なもので、連続的な保護回路動作、過渡時でのご使用に対応するものではありません。

発注形名情報

B D 5 4 6 9 G U L							-	E 2	
品名							パッケージ GUL:VCSP50L1	包装、フォーミング仕様 E2: リール状エンボステーパーピング	

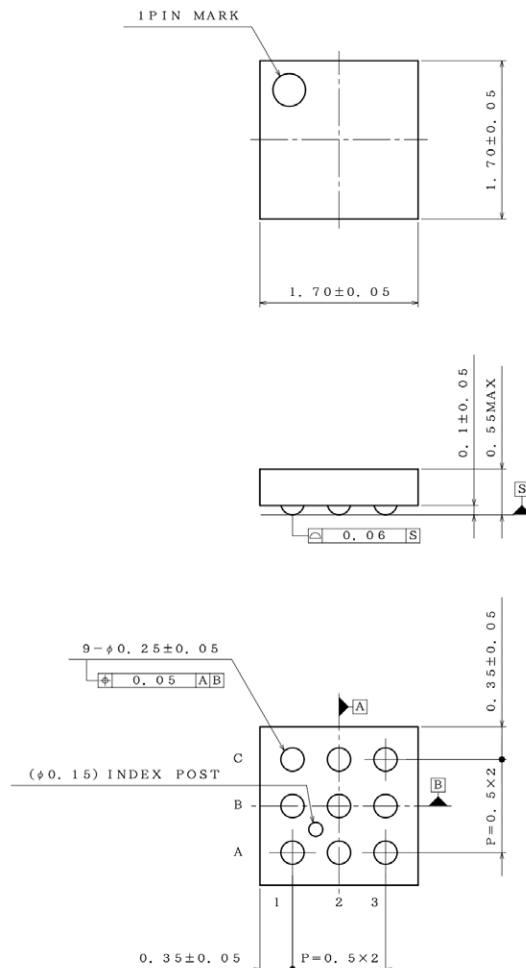
標印図



標印	パッケージ	発注可能形名
5469	VCSP50L1	BD5469GUL-E2

外形寸法図と包装・フォーミング仕様

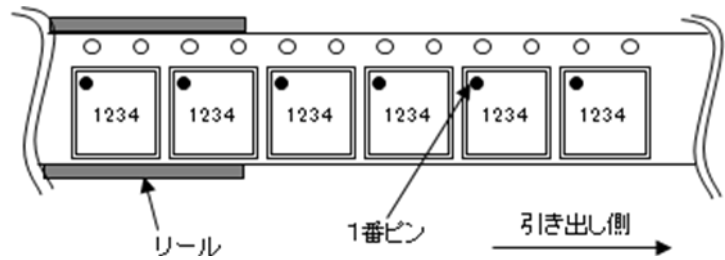
Package Name	VCSP50L1(BD5469GUL)
--------------	---------------------



(UNIT : mm)

< 包装形態、包装数量、包装方向 >

包装形態	エンボステーピング
包装数量	3,000pcs
包装方向	E2 リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに、 製品の1番ピンが左上にくる方向



改訂履歴

日付	版	変更内容
2014.04.04	1.0	新規作成

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。従いまして、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険若しくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。従いまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂ 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実にを行うことをお勧め致します)、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 許容損失(Pd)は周囲温度(Ta)に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、ディレーティングカーブ範囲内であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。従いまして、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施の上、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認した上でご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行った上でご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに QR コードが印字されていますが、QR コードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等（ソフトウェア含む）との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ローム若しくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。但し、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社若しくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。